

Facebook se rapproche du développement de ses propres puces

Facebook a embauché Shahriar Rabii pour prendre le poste de vice-président menant les efforts de développement de puces du groupe, croit savoir [Bloomberg](#).

Il devrait reporter à Andrew Bosworth, responsable des réalités virtuelle et augmentée au sein du groupe dirigé par Mark Zuckerberg.

L'Oculus Go premier visé

Il pourrait donc s'agir de développer des puces pour les casques de réalité virtuelle Oculus.

Pour rappel, en octobre 2017, Facebook a annoncé le casque de réalité virtuelle Oculus Go. Il se distingue des autres casques Oculus par la présence d'une puce gérant localement les tâches de traitement, éliminant ainsi le besoin de le connecter à un PC.

L'Oculus Go embarque le vieillissant SoC (System on Chip) Snapdragon 821 signé Qualcomm. Même si le fabricant de puces a depuis lors annoncé le Snapdragon XR1, une puce plus puissante dédiée aux applications de réalités virtuelle et augmentée.

Mais, pour Facebook, développer sa propre puce lui permettrait de l'adapter à ses besoins spécifiques.

Suivies d'autres puces

Facebook plancherait également sur une enceinte connectée avec écran tactile, pouvant notamment être utilisé pour des conversations vidéo.

Un tel produit pourrait également bénéficier, dans le futur, d'une puce signée Facebook.

Des puces personnalisées pourraient aussi améliorer les efforts du groupe dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le profil LinkedIn de Shahriar Rabii indique qu'il a officié au sein de Google d'octobre 2014 à juillet 2018 en tant que directeur principal de l'ingénierie, responsable de l'ingénierie silicium, de la gestion de produit / programme, production et de ingénierie technologique.

Il est dit qu'il a travaillé sur des produits tels que « *Pixel Visual Core pour ML (apprentissage automatique) et la photographie computationnelle, la famille Titan d'éléments sécurisés, les transcodeurs vidéo VP9 et AV1* ».

ASIC et SoC

En avril dernier, la publication d'offres d'emploi laissait déjà supposer la [volonté du groupe de créer une équipe de développement de puces](#).

La firme était notamment à la recherche d'un responsable pour construire une « *organisation SoC / ASIC, firmware et développement de pilotes de bout en bout* », selon une des offres d'emploi publiée sur le site Web du groupe.

Les SoC (System on Chip) sont des puces intégrant un processeur ainsi que d'autres IP, tels qu'un ISP (Image Signal Processor), un GPU pour les graphismes, un modem cellulaire pour certains... Ils sont largement utilisés dans les smartphones, tablettes et d'autres appareils de petites tailles.

Les ASIC (acronyme de application-specific integrated circuit) sont, eux, des puces spécialisées pour effectuer des tâches précises.

[Amazon](#) aurait aussi l'intention de développer des puces en interne, en particulier pour en équiper de futures enceintes connectées de la gamme Echo.

(crédit photo © ktsdesign – shutterstock)